μCMM

极高精度测量公差非常小的部件

μCMM是同类产品中最精确的纯光学微坐标测量 系统。用户将触觉坐标测量技术和光学表面测量 技术的优势结合起来,只用一个传感器测量零件 的尺寸、位置、形状和粗糙度。μCMM提供了更 高几何精度的光学三维测量,能够测量大部件上 的小表面细节,并精确确定这些单独测量的相对 位置。

可测量表面的光谱包括所有常见的 工业材料和复合材料,如塑

料、PCD、CFRP、陶瓷、铬、硅。 材料从哑光到抛光各种反光成分都 可以测量。操作简单是通过单按钮 解决方案,有一个集自动化和人体 工程学控制元素特别设计的控制 器。带线性驱动的空气轴承轴可实 现无磨损使用和高精度、以及更快 速测量。这也使得μCMM非常适合 在生产中永久使用。





AdvancedReal3D RotationUnit G2







AdvancedInsertGrip



InsertGrip G2





alicona

总体参数

测量点数量	单一测量: X: 1720, Y: 1720, X x Y: 2.95 million 组合测量: up to 500 million				
测量范围(X x Y x Z)	310 mm x 310 mm x 310 mm = 29 791 000 mm ³				
压缩空气	免维护根据规范使用压缩空气,6bar				
轴线移动速度	up to 100 mm/s				
同轴照明	LED同轴照明(彩色),大功率,电子控制				
物镜转换盘	自动气动四位物镜转换器				
系统监控	9个温度传感器(精度: ±0.1 K), 3个振动传感器,内部电流和电压监测,包括长期记录,可获取记录				
控制中心	4 Core, 32 GB DDR4, HDD 2 TB, Windows 10 IoT Enterprise 64bit, 2x 27 " Full HD LED Monitor				

尺寸

尺寸 (W x D x H)	测量仪器: 960 x 1109 x 1958 mm(高达2288 mm);控制服务器:200 x 490 x 440 mm
质量	测量仪器: 1250 kg (含钢支架) ; 控制服务器:16.9 kg

测量对象

样品最大重量	30 kg; 如需更大请咨询
样品最大尺寸	宽度: 680 mm, 高度: 375 mm

精度

1142							
三维精度10360-8 (*)		E _{UniCTr.ODS,MPE} = (0.8 + L/600) μm (L in mm) (**) E _{UniZStODS,MPE} = (0.15 + L/50) μm (L in mm) (***)					
平面度偏差	1.6 mm x 1.6 mm with 10x objective	U = 0.1 μm					
轮廓粗糙度	Ra = 0.1 µm Ra = 0.5 µm	U = 0.012 μm, σ = 0.001 μm U = 0.02 μm, σ = 0.001 μm					
面粗糙度	Sa = 0.1 μm Sa = 0.5 μm	U = 0.01 μm, σ = 0.001 μm U = 0.015 μm, σ = 0.001 μm					
楔角	β = 70° - 110°	U = 0.075°, σ = 0.01°					
钝化半径	R = 5 μm - 20 μm R > 20 μm	U = 1.5 μm, σ = 0.15 μm U = 2 μm, σ = 0.3 μm					

- The values given are based on ISO 10360-8 and VDI 2617. Valid for all MultiMeasurements.
- (*) The values given are based on ISO 10360-8 and VDI 2617.
 (**) Valid for all MultiMeasurements.
 (***) Valid for single measurements, height step measurements.

物镜参数

物镜种类		1500A	800A	400A	150A	80A
工作距离	mm	23.5	17.5	19	11	4.5
单一视野水平测量范围						
(X, Y)	mm	2.63	1.32	0.66	0.26	0.13
(X x Y)	mm²	6.91	1.71	0.43	0.06	0.01

